



# 电子行业周报：从半导体行业景气度看设备、材料的确定性



从全球龙头看景气高度，供不应求持续。在前期报告《科技龙头：全球处在景气的哪个阶段？》之中，我们整理了全球科技龙头业绩、近况、以及部分厂商对于未来的展望，可以看到的是核心晶圆厂及设备制造龙头的订单持续满载，供不应求，推动了龙头们的收入及毛利率持续性提高，且订单的可见度延伸至 2023 年。从需求端来看，从 ST 和 NXP 到高通，AMD，Intel 之类的厂商均看到了汽车、服务器、PC 等需求都处于旺盛阶段，且行业即将进去三季度旺季，有望实现景气度的进一步提振。

高景气度推动高 Capex，新产能建设持续推动，国产化材料及设备加速，紧抓机会。随着全球半导体景气度依旧保持高位，且供需不平衡迟迟未得到缓解，全球晶圆厂均处于加大 Capex 支出，加速扩建产能的阶段。从全球来看，2021~2022 年全球预计新建 29 座晶圆厂，其中 2021 年开始投建 19 座，2022 年开始投建 10 座。新建晶圆厂中产能最高可达每月 40 万片，29 座晶圆厂建成后，全球晶圆约产能会增长 260 万片/月。其中中国大陆 2020 年 12 英寸晶圆产能约 38.8 万片/月，所有已宣布中国大陆本土厂商 12 英寸晶圆产能的合计目标 145.4 万片/月，意味着中国大陆将有大量的增量产能即将逐步投建、释放。伴随着巨大的产能增长，以及中国所不断推进的国产替代，我们有望看到国产设备及材料在这轮假设周期之中的加速替代。

国内设备国产化逐渐起航，从 0 到 1 的过程基本完成。北方华创刻蚀、沉积、炉管持续放量；中微公司 CCP 打入 TSMC，ICP 加速放量；精测电

子产品迭代加速，OCD、电子束进展超预期；华峰测控订单饱满，新机台加速放量。Mattson（屹唐半导体）在去胶设备市占率全球第二。盛美半导体、至纯科技清洗设备逐步放量。精测电子、上海睿励在测量领域突破国外垄断。

沈阳拓荆 PECVD 打入生产线量产，ALD 有望突破。

国内半导体材料厂商国产化加速，价量齐升推动市场加速增长。鼎龙股份 CMP 抛光垫全面切入客户，彤程新材 IC 光刻胶持续放量，兴森科技 IC 载板持续扩产放量，上海新阳 KrF 突破且获得订单，中国半导体材料厂商国产化进度全面加速。此外随着半导体晶圆扩产的制程及尺寸的升级，有望看到材料的价量齐升，带动材料市场的进一步增长。

高度重视国内半导体产业格局将迎来空前重构、变化，以及消费电子细分赛道龙头：1) 半导体核心设计：光学芯片、存储、模拟、射频、功率、FPGA、处理器及 IP 等产业机会；2) 半导体代工、封测及配套服务产业链；3) VR、Miniled、面板、光学、电池等细分赛道；4) 苹果产业链核心龙头公司。

**预览已结束，完整报告链接和二维码如下：**

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_34488](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_34488)

